



Karta Techniczna

IZOHAN STYROPUK ELEWACJA

klej poliuretanowy

Dane techniczne:

Temperatura pracy: od -5°C do +30°C

(temperatura podłoża do +60°C w przypadku papy i blachy stalowej ocynkowanej)

Temperatura puszk: od +10°C do +25°C

Czas korekty: do ok. 10 min.*

Czas kołkowania: po ok. 2 godz.

Czas pełnego utwardzenia: po 12 godz.

Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C

Gęstość pozorna: 26 ± 15% kg/m³

Przyrost wysokości piany (stopień ekspansji): ± 3,0 mm

Wytrzymałość na ścinanie: ≥ 60 kPa

Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu: ≥ 130 kPa

Stabilność wymiarów, po 48 h, w temp +60°C i 30% RH, w kierunku:

a) długości	± 0,5%
b) szerokości	± 1,0%
c) grubości	± 1,5%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni, połączeń ze spoiną klejową 8 mm:

- EPS – beton ≥ 0,08 MPa
- EPS – papa ≥ 0,08 MPa
- EPS – blacha stalowa ocynkowana ≥ 0,08 MPa
- EPS – blacha stalowa ocynkowana z powłoką organiczną ≥ 0,08 MPa
- EPS – płyta OSB ≥ 0,08 MPa
- EPS – drewno ≥ 0,08 MPa
- EPS – EPS ≥ 0,08 MPa

- XPS – beton ≥ 0,08 MPa
- XPS – papa ≥ 0,08 MPa
- XPS – blacha stalowa ocynkowana ≥ 0,08 MPa
- XPS – blacha stalowa ocynkowana z powłoką organiczną ≥ 0,08 MPa
- XPS – płyta OSB ≥ 0,08 MPa
- XPS – drewno ≥ 0,08 MPa
- XPS – XPS ≥ 0,08 MPa

(warunki dot. połączeń wymienione w KDWU)

Zużycie: ok. 8 - 12 m² z puszk

Opakowania: 750 ml (puszka)

Zastosowanie:

IZOHAN STYROPUK ELEWACJA jest stosowany do:

- mocowania płyt z białego polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do:
 - podłoży mineralnych (betonowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS), przy czym płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) powinny być jednocześnie mocowane mechanicznie,
 - podłoży mineralnych (betonowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego), podłoży drewnianych, z płyt OSB, blachy stalowej ocynkowanej, blachy stalowej ocynkowanej z powłoką organiczną lub z papy asfaltowej w innych zastosowaniach zewnętrznych, z wyjątkiem dachów płaskich.
- mocowania płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do płyt z białego EPS
- mocowania płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do płyt z XPS.
- przyklejania kasetonów styropianowych, paneli ściennych
- montażu parapetów
- wypełniania szczelin w izolacji termicznej

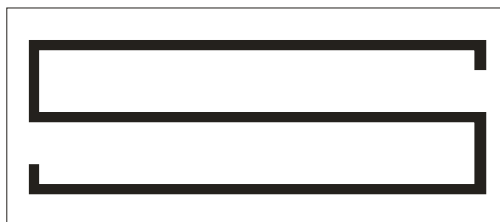
Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być płaskie, równe, suche, czyste pozbawione kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych zanieczyszczeń, które mogą spowodować brak odpowiedniej przyczepności kleju do podłoża. Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni od płaskości ściany nie może przekraczać -4 mm i +2 mm. Należy sprawdzić przyczepność istniejących powłok malarskich bądź tynków, odchodzące warstwy wymienionych podłoży należy usunąć. Zamocować listwy startowe.

Sposób stosowania:

Przed przystąpieniem do klejenia należy intensywnie wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Puskę przykręcić do pistoletu i dozować w pozycji 'do góry dnem'. Jeśli prace zostaną przerwane na dłużej niż 15 minut, należy zablokować spust, pozostawiając nakręconą puszkę do następnego użycia.

Pianę do styropianu należy nakładać warkoczem o średnicy około 3 cm na płytę termoizolacyjną po obwodzie z zachowaniem odstępów od jej krawędzi około 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Należy pozostawić około 5 cm przerwy w pasmach kleju, nakładanych na przeciwległych krawędziach płyty (tak jak przedstawiono to na poniższym rysunku). Pasma powinny mieć szerokość około 3 cm. Grubość utworzonej spoiny powinna wynosić (po przyłożeniu płyty do podłoża) 8 lub 15 mm



Połączenie płyt termoizolacyjnych z podłożem należy wykonać jak najszybciej po nałożeniu kleju. Czas otwarty, tj. czas zachowania zdolności klejenia w temperaturze $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i $(50 \pm 5)\%$ wilgotności względnej, wynosi maksymalnie 5 minut. Ustawienie płyt można korygować do 10 minut od ich przyłożenia do powierzchni ściany.

Przy narożnikach stosować podpory do momentu związania kleju, tj. ok. 10 minut. Po stwardnieniu piany (po ok. 2 h) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przymocować dodatkowo specjalnymi łącznikami mechanicznymi w ilości min. 4 szt./ m^2 , a wzdłuż krawędzi budynku min. 8 szt./ m^2 .

Po opróżnieniu opakowania pistolet należy przeczyszczyć płynem czyszczącym do pistoletów i piany PU. Po pełnym utwardzeniu pianę można usunąć mechanicznie.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Właściwości:

- umożliwia szybkie wykonanie prac (wstępne utwardzenie po 2 godzinach, pełne utwardzenie już po 12 godzinach*)
- jednoskładnikowy, niskoprężny
- łatwy i wygodny w użyciu
- bardzo wydajny
- stosowany w szerokim zakresie temperatur, szczególnie polecany w okresach chłódów jesienno-wiosennych
- wykazuje doskonałą przyczepność do wielu rodzaju podłoży

Przechowywanie:

W pomieszczeniach suchych, chłodnych (z dala od urządzeń grzewczych), wyposażonych w wentylację mechaniczną w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji pionowej w temp. $+5^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 24 miesiące.

Uwagi:

*Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury $+23^{\circ}\text{C}$ i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i niższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Zużycie materiału zależne jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz podłoża, temperatury puszk, równości podłoża, przekroju nałożonej warstwy.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność.